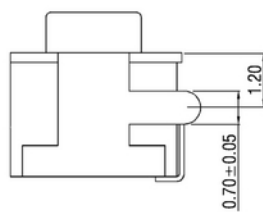
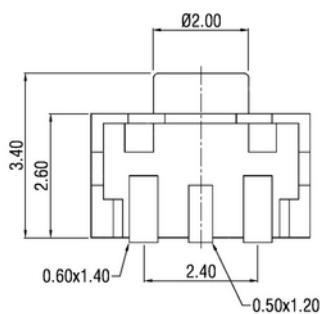


Technische Daten / Technical Data

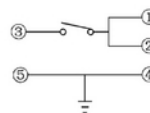
Gehäuse/Abdeckung/Hebel	Thermoplast/Stahl/Thermoplast
Case/Cover/Actuator	Thermoplastic/Steel/Thermoplastic
Kontaktmaterial	Messing
Contact Material	Brass
Kontaktbelastbarkeit	50mA, 12V _{DC}
Contact Rating	50mA, 12V _{DC}
Kontaktoberfläche	Versilbert
Contact Surface	Silver plated
Oberfläche Lötanschluss	Versilbert
Plating Solder Side	Silver plated
Lötbarkeit	IEC512-12A
Solderability	IEC512-12A
Durchgangswiderstand	< 100mΩ im Auslieferungszustand
Contact Resistance	< 100mΩ at initial state
Isolationswiderstand	> 100MΩ im Auslieferungszustand
Insulation Resistance	> 100MΩ at initial state
Spannungsfestigkeit	250V _{AC}
Test Voltage	250V _{AC}
Temperaturbereich	-20°C ... +70°C
Temperature Range	-20°C ... +70°C
Mechanische Lebensdauer	min. 50 000 Schaltvorgänge (160g)
Mechanical Life	min. 50 000 operations (160g)
	min. 20 000 Schaltvorgänge (250g)
	min. 20 000 operations (250g)
Verarbeitung	Reflow-Lötverfahren
Processing	Reflow soldering



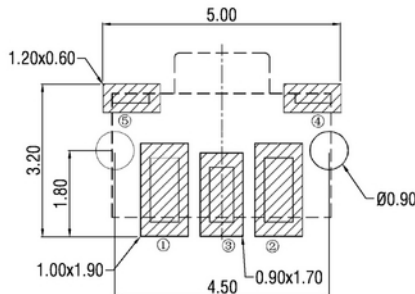
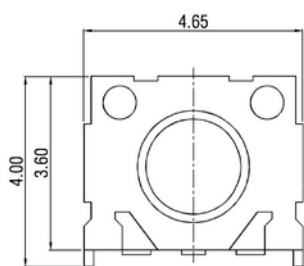
© W+P PRODUCTS



Recommended PCB Layout



Circuit Diagram



Series	Height	Force	Loc. Peg*	Packing*
515	1 1 H=3.40mm	30 30 160g±30 40 250g±50	10 00 Ohne Pos.hilfe W/o loc. peg 10 Mit Pos.hilfe With loc. peg	TR 00 TR

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** - bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** - please replace by your specifications.

Lieferformen / Packing Options:

- 00 Schüttgut / Bulk good
- TR Tape&Reel Verpackung / Tape&Reel Packing

Informationen zum kurzen Reflow-Lötverfahren

Fast Profile Reflow-Soldering Information

Reflow-Löttempfehlung

Reflow Soldering Recommendation

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J_STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Vorwärm-Temperatur T_S	100°C
Dauer Vorwärmen	40s
Höchsttemperatur	260°C ±5
Dauer Höchsttemperatur	3s ±0.5
Verarbeitungstemperatur	255°C ±5
Lötdauer	3s ±0.5

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Warm-Up Temperature T_S	100°C
Warm-Up Duration	40s
Peak Temperature	260°C ±5
Duration Peak Temperature	3s ±0.5
Soldering Temperature	255°C ±5
Soldering Duration	3s ±0.5